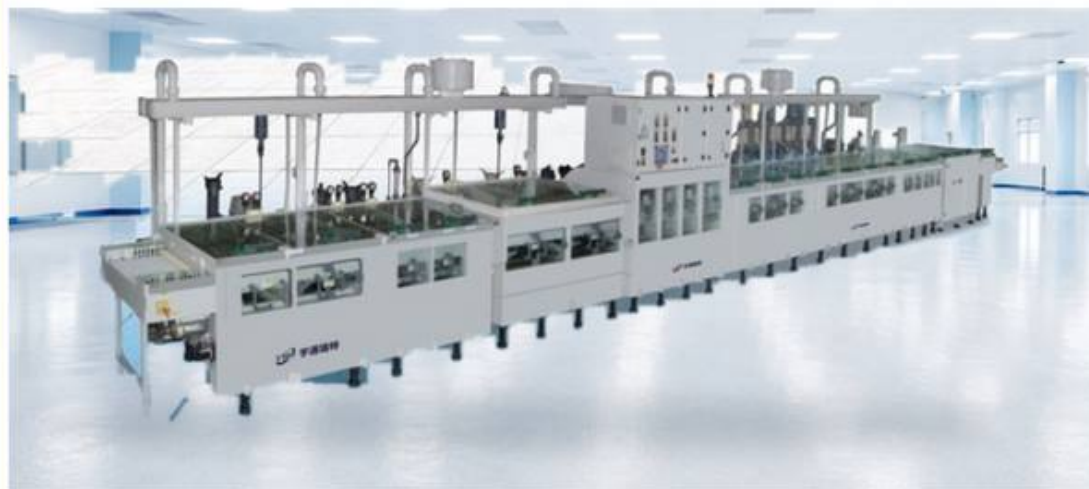


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Горизонтальные и вертикальные линии мокрых процессов
для PCB, FPCB, керамических подложек и полупроводников.



НАДЁЖНОСТЬ

Стабильные процессы

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интеграция с MES

СЕРВИС

Поддержка и обучение

ИММЕРСИОННОЕ СЕРЕБРО



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Равномерное блестящее серебряное покрытие.
- Тонкая фильтрация раствора обеспечивает чистоту процесса.
- Двусторонний водяной нож и равномерная сушка.
- Регулировка давления и расхода раствора.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирование паяемого иммерсионного серебряного покрытия.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



ШЛИФОВАЛЬНО-ЩЁТОЧНАЯ ЛИНИЯ

17



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сниженный уровень шума и вибрации.
- Диапазон толщины обрабатываемых плат: 0,1–3,2 мм.
- Автоматическое определение толщины платы.
- Замена щёточного узла менее чем за 3 минуты.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление оксидов, загрязнений и формирование равномерной шероховатости.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

